PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-044834

(43)Date of publication of application: 16.02.1999

(51)Int.Cl.

G02B 7/02 G02B 7/00 G03F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number : 09-213875

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

25.07.1997

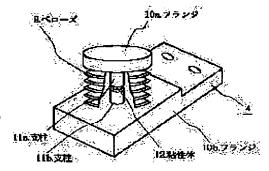
(72)Inventor: MIZUNO MAKOTO

(54) OPTICAL ELEMENT MOVING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize in a space saved state with high cleanness an optical element moving device accurately driving an optical element for adjusting the optical characteristic of a projection optical system on an optical axis by providing a damper means between a movable part and a fixed part.

SOLUTION: This device is provided with the damper means between the movable part and the fixed part. Namely, in this device, the driving element 4 is constituted of a bellows 9, etc., and its one end is fixed on a fixed base and the other end is fixed on a clamp top board coupled with a movable base. The element 4 is constituted of the bellows 9, two flanges 10a and 10b, columns 11a and 11b and a viscous body 12 interposed in a gap between the columns 11a and 11b. One flange 10a is coupled with the clamp top board through the gap of a leaf spring piece and the other flange 10b is arranged in the fixed base, so that air pressure applied to the inside of the bellows 9 is transmitted to the movable base. By using such a driving element 4 damping



movable base. By using such a driving element 4, damping characteristic is added to the operation of a mechanism.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3445105

[Date of registration]

27.06.2003

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平11-44834

(43)公開日 平成11年(1999)2月16日

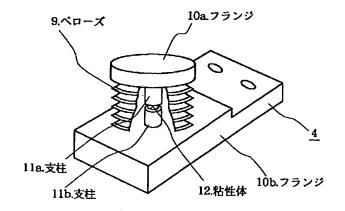
								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, _,,
(51) Int. C1.6		識別記号		FI			-		
G 0 2 B	7/02			G 0 2 B	7/02		Α		
	7/00				7/00		В	,	
G 0 3 F	7/20	5 2 1		G 0 3 F	7/20	5 2 1			
H01L	21/027			H01L	21/30	5 1 5	D		
						5 1 6	Α		
	審査請求	未請求 請求項の数22	F D			(全1	2頁)		
(21)出願番号	特願平9-213875			(71)出願人	000001	.007	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					キヤノ	ン株式会社	£		
(22)出願日	平成9年(1997)7月25日			東京都	大田区下す	1子3丁	1目30番2号	<u>.</u>	
			ĺ	(72)発明者	水野	誠			
					東京都 株式会	大田区下丸 社内	ኒ子3丁	目30番2号	キヤノン
				(74)代理人	弁理士	伊東 巷	护也	(外2名)	
		•		·					
			ļ					•	
								•	

(54) 【発明の名称】光学要素移動装置

(57)【要約】

【課題】 投影光学系の倍率、収差、歪み等の光学特性 を調整するための光学要素を髙精度で光軸上を駆動する 光学要素移動装置を、省スペース、高クリーン度で実現 する。

【解決手段】 可動部に取り付けられた光学要素を固定 部に対して光軸方向へ移動させる駆動手段および案内手 段を有する光学要素移動装置において、可動部と固定部 との間にダンパ手段を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固定部と、光学要素を固定された可動部 と、前記固定部に対して前記可動部を光軸方向へ移動さ せる駆動手段および案内手段と、前記固定部と可動部と の間に配置されたダンパ手段とを有する光学要素移動装 置。

【請求項2】 前記ダンパ手段が、光軸対称に配置され ていることを特徴とする請求項1記載の光学要素移動装

【請求項3】 前記ダンパ手段が、防塵用ベローズ内に 10 配置されていることを特徴とする請求項1または2記載 の光学要素移動装置。

【請求項4】 前記ダンパ手段が、前記駆動手段内部に 設けられていることを特徴とする請求項1または2記載 の光学要素移動装置。

前記ダンパ手段が、粘性体を具備するこ 【請求項5】 とを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の光 学要素移動装置。

【請求項6】 前記ダンパ手段が、粘性体を具備するこ とを特徴とする請求項4記載の光学要素移動装置。

【請求項7】 前記粘性体が、平面の間に挟まれている ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1つに記載の 光学要素移動装置。

【請求項8】 前記ダンパ手段が、シリンダおよびピス トンとこれらのシリンダとピストンの間に配置された粘 性体からなることを特徴とする請求項7記載の光学要素 移動装置。

【請求項9】 前記粘性体が、オイル、グリースまたは ゲルであることを特徴とする請求項5~8のいずれか1 つに記載の光学要素移動装置。

【請求項10】 前記駆動手段が、前記固定部および可 動部にそれぞれ固定される一対のフランジ部とこれらの フランジ部間に配置されたアクチュエータからなり、該 フランジ部の少なくとも一方に前記ダンパ手段を取り付 けるための開口と、該ダンパ手段を取り付けた後該開口 との隙間をシールするための溝およびOリングを持つこ とを特徴とする請求項6記載の光学要素移動装置。

【請求項11】 前記ダンパ手段が、筒形または中空の 防振ゴムを具備することを特徴とする請求項1~3のい ずれか1つに記載の光学要素移動装置。

【請求項12】 前記防振ゴムが、前記固定部および可 動部の防振ゴム取り付け部に溝または段を設けてはめ込 むか、または接着により、前記固定部および可動部に固 定されていることを特徴とする請求項11記載の光学要 素移動装置。

【請求項13】 前記ダンパ手段が、筒形または中空の 防振ゴムを具備することを特徴とする請求項4記載の光 学要素移動装置。

【請求項14】 前記駆動手段が、前記固定部および可

フランジ部間に配置されたアクチュエータからなり、前 記防振ゴムが、前記フランジ部に設けられた溝または段 にはめ込まれるか、または前記フランジ部に接着される ことにより、前記フランジ部に固定されていることを特 徴とする請求項13記載の光学要素移動装置。

前記駆動手段が、内部の流体の作用に 【請求項15】 より、前記可動部を駆動する駆動用ベローズを有し、前 記防振ゴムの前記光軸方向の長さが、該駆動用ベローズ と同一であることを特徴とする請求項13または14記 載の光学要素移動装置。

【請求項16】 前記防振ゴムが、1個以上の穴を有す ることを特徴とする請求項11~15のいずれか1つに 記載の光学要素移動装置。

【請求項17】 前記ダンパ手段が、ショックアブソー バを具備することを特徴とする請求項1~3のいずれか 1つに記載の光学要素移動装置。

【請求項18】 前記ダンパ手段が、ショックアブソー バを具備することを特徴とする請求項4記載の光学要素 移動装置。

20 【請求項19】 前記駆動手段が、前記固定部および可 動部にそれぞれ固定される一対のフランジ部とこれらの フランジ部間に配置されたアクチュエータからなり、該 フランジ部の少なくとも一方に前記ショックアブソーバ を取り付けるための開口と、該ショックアプソーバを取 り付けた後該開口との隙間をシールするための溝および Oリングを持つことを特徴とする請求項18記載の光学 要素移動装置。

【請求項20】 内部にダンパ手段を備えたことを特徴 とするベローズ。

【請求項21】 請求項1ないし19のいずれかに記載 30 の光学要素移動装置を具備する光学装置を投影光学系と して備え、レチクルのパターンをウエハに投影露光する 手段を有することを特徴とする露光装置。

【請求項22】 請求項21に記載の露光装置を用いて 製造したことを特徴とする半導体デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、露光装置などの投 影光学系の倍率、収差、歪み等の光学特性を調整するた 40 めの光学要素移動装置に関し、さらに詳細には、半導体 焼付け装置 (マスクアライナ) などで使用される投影光 学系において、原版(例えばマスクおよびレチクル)の 像を対象物(例えばウエハ)に投影露光する際、より正 確な結像関係を得るための付加光学系に用いられる光学 要素移動装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体露光装置は、数多くの異なる種類 のパターンを有する原版(レチクル)をシリコンウエハ (基板) に転写する装置である。 高集積度の回路を作成 動部にそれぞれ固定される一対のフランジ部とこれらの 50 するためには、解像性能だけでなく重ね合せ精度の向上

30

3

が不可欠である。

【0003】半導体露光装置における重ね合せ誤差はアライメント誤差、像歪み、および倍率誤差に分類される。アライメント誤差は、原版(レチクル)と基板(ウエハ)との相対位置調整によって軽減される。一方、倍率誤差は、投影光学系の一部を光軸方向に移動させることによって調整可能である。光軸方向に移動させる際には、移動方向以外の他成分、とりわけ平行偏心、および傾き誤差が大きくならないようにしなければならない。

【0004】従来、半導体露光装置用の投影倍率調整装 10 置としては、特開平9-106944号公報に開示され ているような平行板ばねを用いた機構による光学要素移 動装置が考案されている。図1はこの種の光学要素移動 装置が搭載される露光装置の全体図、図2は、上記公報 に開示された機構を示す一部破断平面図および断面図で ある。図2に示すように、この光学要素移動装置は、倍 率、収差等の調整レンズ7、およびそれを支持するセル 8を積載する可動台1および図1の投影光学系104の 固定部分の一部をなす固定台2を有する。駆動要素4 は、ベローズなどによって構成され、その一端を固定台 20 2に固定されるとともに、他端は可動台1に連結される クランプ天板5に固定されている。可動台1と固定台2 は、2枚以上で一組の板ばね片3を有する板ばね材を一 対とそれを支持する板ばね押さえ6を有するばね機構に より連結されている。板ばね材は、可動台1および固定 台2の両端面にそれぞれ一個ずつ配置されている。駆動 要素4は、板ばね片3の隙間であって、可動台1の中心 から等距離、かつ光軸20に対称な位置に配置されてい

【0005】図22に上記公報に記載された駆動要素4の概要を示す。同図の駆動要素4は、ベローズ9と、2個のフランジ10aおよび10bによって構成されている。また、一方のフランジ10aは、図2に示すように、板ばね片3の隙間からクランプ天板5に連結され、他方のフランジ10bは、固定台2内に配置されており、ベローズ9内部に与えられる空気圧力を可動台1に伝達する。

【0006】このような従来例は、レンズの位置を髙精度で制御できる上に、より軽量に、またより小さな空間で実現することができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の平行板ばねを用いた機構による光学要素移動装置では、光学要素を高精度で光軸上を駆動することができない場合があるという問題がある。例えば重量の大きい、かつ大口径のレンズを可動部とし、板ばねを案内に用いた機構の場合、固有振動数が比較的低いため、外乱などによりレンズを含む可動部が大きく振動するという問題がある。その結果、露光装置の転写性能が低下する傾向となるため、光学要素移動装置に減衰特性を持たせることが 50

望ましいことが判明した。

【0008】本発明の目的は、このような従来技術の問題点に鑑み、投影光学系の倍率、収差、歪み等の光学特性を調整するための光学要素を高精度で光軸上を駆動する光学要素移動装置を、省スペース、高クリーン度で実現することにある。

4

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するため、本発明では、可動部に取り付けられた光学要素を固定部に対して光軸方向へ移動させる駆動手段および案内手段を有する光学要素移動装置において、可動部と固定部との間にダンパ手段を設けたことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の好ましい実施の形態において、ダンパ手段としては、粘性体を具備するもの、防振ゴムを具備するもの、およびショックアブソーバなどを用いることができる。このようなダンパ手段は、光軸対称に配置することが好ましい。また、前記駆動手段内部に設けることも可能であるが、特にダンパ手段を前記駆動手段とは別個に設ける場合、該ダンパ手段からの発塵を防止するためベローズ内に配置することが好ましい。

【0011】前記ダンパ手段が粘性体を具備するもので ある場合、この粘性体としては、オイル、またはグリー ス、またはゲル等を用いることができる。また、粘性手 段は、平面の間に挟んでもよく、シリンダとピストンと の間に配置してもよい。また、ダンパ手段を駆動手段内 部に設ける場合、駆動手段のフランジ部にダンパ手段を 取り付けるための開口を設け、ダンパ手段をこの開口に、 取り付けた後、フランジ部に設けた溝にはめ込んだOリ ングにより、ダンパ手段と開口との隙間をシールする。 【0012】前記ダンパ手段が、防振ゴムを具備するも のである場合、この防振ゴムとしては、円筒形状または 中空の立方体形状のものを用いることができる。この防 振ゴムには1個以上の穴を設けることが好ましい。この 防振ゴムは駆動手段のフランジ部または固定部および可 動部に構または段を設けてはめ込むか、接着するか、ま たはこれらを組み合わせて、前記フランジ部または固定 部および可動部に固定することが好ましい。さらに、防

【0013】前記ダンバ手段がショックアブソーバを具備するものであり、これを駆動手段内部に設ける場合、駆動手段のフランジ部にショックアブソーバを取り付けるための開口を設け、ショックアブソーバをこの開口に取り付けた後、フランジ部に設けた溝にはめ込んだOリングにより、ショックアブソーバと開口との隙間をシールする。

40 振ゴムは駆動手段の一部であるベローズと同一寸法とす

[0014]

ることが好ましい。

【作用】固定部と可動部との間にダンパ手段を設けるこ

とにより、光学要素駆動時の振動を抑えることができ、 省スペースでありながら、高精度な光学要素駆動を実現 することができる。また、ダンパ手段を駆動手段内部に 設けたり、またはベローズなどで覆うことにより、高ク リーン度を実現することができる。

[0015]

【実施例】以下、図面を用いて本発明の実施例を説明す

[実施例1] 図1は、本発明が適用される露光装置の概 略構成を示す図である。同図において、101は感光剤 10 が塗布された半導体ウエハであり、精密な位置決め性能 を有するウエハステージ102上に保持されている。露 光装置の基準に対するウエハステージの位置はレーザ干 渉計113によって計測されている。103は原版とな るパターンが描かれたレチクルである。投影光学系10 4は本発明による光学要素移動手段110を有してお り、レチクル上のパターンをウエハ上に結像させる。1 05はレチクルを照明するための照明光学系である。1 06は前行程で作成されたウエハ上のパターンとレチク ル上のパターンとの位置ずれを検出するアライメント光 20 学系である。アライメント光学系 1 0 6 とウエハステー ジ102とによって、レチクル上のパターンとウエハ上 のパターンとを重ね合わせた上で露光する。107はこ のような露光装置の動作を管理する制御装置である。ア ライメント光学系と、ウエハステージおよびウエハステ ージの位置を計測するレーザ干渉計とが協働することに よって、ウエハ上のパターンの寸法を計測することがで きる。制御装置はこの寸法から最適な光学特性が得られ る光学要素の位置を設定する。一方、投影光学系の光学 特性の一つである投影倍率の変動要因として、気圧など 30 の雰囲気の変化がある。制御装置107は、気圧センサ 108によって得られる気圧の情報や最適な露光倍率の 値から、前記光学要素の一つである投影倍率調整用のレ ンズの最適な位置を決定し、その位置の指令を光学要素 移動手段の制御部111に与える。図1において、10 9は投影光学系104を支持する定盤(下)、112は 定盤(下)109に支持され照明光学系105やアライ メント光学系106を支持する定盤(上)である。

【0016】図2は、本発明の一実施例に係る平行ばね 式光学要素移動機構の平面図および断面図を示す。同図 40 の機構は、倍率、収差等の調整レンズ7およびそれを支 持するセル8を積載する可動台1および図1の投影光学 系104の固定部の一部をなす固定台2を有する。 駆動 要素4は、ベローズなどによって構成され、その一端を 固定台2に固定されるとともに、他端は可動台1に連結 されるクランプ天板5に固定されている。可動台1と固 定台2は、2枚以上で一組の板ばね片3を有する板ばね 材を一対とそれを支持する板ばね押さえ6を有するばね 機構により連結されている。板ばね材は、可動台1およ び固定台2の両端面にそれぞれ一個ずつ配置されてい

る。駆動要素4は、板ばね片3の隙間であって、可動台 1の中心から等距離、かつ光軸20に対称な位置に配置 されている。図2において、16は継手、21はロック 用ねじ、22はターゲット板、23はバランス板、24 は位置センサ、25はセンサホルダである。

【0017】図3は、本発明の第1の実施例に係る駆動 要素の断面を示す。同図の駆動要素4は、ベローズ9 と、2個のフランジ10aおよび10bと、支柱11a および11bと、支柱11aと11bの隙間に挟持され た粘性体12とによって構成されている。また、一方の フランジ10 aは、図2に示すように、板ばね片3の隙 間からクランプ天板5に連結され、他方のフランジ10 bは、固定台2内に配置されており、ベローズ9内部に 与えられる空気圧力を可動台1に伝達する。

【0018】本実施例のようなベローズ9内部にグリー ス、オイルまたはゲルなどの粘性体12を配置した駆動 要素4の場合、機構の動作に減衰特性を加えることがで き、かつ粘性体12から発生する塵などを圧縮空気部か ら出さないという点で高クリーン度を実現することがで きる。

【0019】ベローズ9の自由長さは、駆動時の動作安 定のために、セット長より長くとるが、ベローズ9の内 部に配置する粘性体12の厚さも、ベローズ9の有効ス トローク長と同一寸法になるように調整することが望ま しい。

【0020】粘性体12の配置方法は、図3に示すよう に、両側のフランジ10aと10bから設けた支柱11 aと11bの隙間に配置することができる他、図4

(a) に示すように、片側のフランジ10 aから設けた 支柱11と他方のフランジ10bとの隙間に配置するこ とができる。図4 (a) は、上側のフランジ10 aから 支柱11を設けた例である。この支柱11は、図のよう にフランジ10aと一体で形成するか、あるいは別部品 として形成してもよい。

【0021】図4(b)は、粘性体12をシリンダの配 置に設けた場合である。すなわち、一方のフランジ10 aに設けられた支柱であるピストン13と、他方のフラ ンジ10bから設けられたシリンダ14との間に粘性体 12を配置した例である。

【0022】図4 (c) は、粘性体12を駆動要素4に 後から注入できるように、フランジ10bに穴が設けて ある例である。この穴は、粘性体12注入後にOリング 15とふた17を用いて栓をする。この例は、ベローズ 9が溶接式の場合など、成形時に高温になる場合に有効 である。

【0023】図5(a)は、シリンダ14をフランジ1 0 bに後から取り付けることのできる構成例である。シ リンダ14は、粘性体12を入れた後、ねじとOリング 15を利用してフランジ10bに固定される。この例 も、ベローズ9が溶接式の場合など、成形時に高温にな

50

る場合に有効である。この例の場合、ピストンはフラン ジ10aにねじ止めしても一体で形成してもよい。

【0024】図5(b)は、シリンダ14内に粘性体1 2を後から注入することができるように、穴があけられ ている。この穴は、粘性体12を注入した後に〇リング 15とふた17で栓をする。この例も、ベローズ9が溶 接式の場合など、成形時に高温になる場合に有効であ る。この例の場合、ピストンはフランジ10aにねじ止 めしても一体で形成してもよい。

【0025】図5(c)は、ピストン13内に穴をあ け、後から粘性体12を注入できるようにした構成例で ある。この穴は、粘性体12を注入した後に〇リング1 5とふた17で栓をする。この例も、ベローズ9が溶接 式の場合など、成形時に高温になる場合に有効である。 この例の場合、ピストンはフランジ10aにねじ止めし ても一体で形成してもよい。

【0026】このように、粘性体12を用いたダンパの 場合、粘性体12の厚さを少なくした方が、あるいは粘 性体12との接触面積を大きくした方が制振効果が大き い。しかしながら、本実施例のようにダンパを配置する 20 スペースが狭い場合、特にシリンダ型のダンパの場合、 図6(a)に示すようなピストンの先端形状よりも、図 6 (b) に示すような複数の切り欠きを設けた方が粘性 体12との接触面積が増し、大きな制振効果を得ること ができる。

【0027】 [実施例2] 図7は、本発明の第2の実施 例に係る光学要素移動機構の平面図および断面図を示 す。本実施例は、粘性体12から発生する塵などが周囲 の環境に影響を及ぼさないために、金属のベローズ (不 図示)などで覆った制振機構を、クランプ天板5に取り 付けたターゲット板22または固定金具23と固定台2 に取り付けたセンサホルダ25または固定金具26の間 に配置する構成となっている。図7の例では、3個の制 振機構を取り付けた場合を示している。

【0028】制振機構は、図8に示すように、平面間に オイル、グリースまたはゲルなどの粘性体12を挟む か、あるいはシリンダ状にしてシリンダ14とピストン 13との間に粘性体12を入れるのが望ましい。また、 シリンダ14およびピストン13は、ターゲット板22 または固定金具23と、あるいはセンサホルダ25また 40 は固定金具26と一体で形成しても別体で形成してもよ い。27a。27bは中継ブロックである。

【0029】図7に示す光学要素移動機構ではクランプ 天板5に光軸周りに8カ所の面取りを設け、そのうち1 カ所に可動台1の位置を計測するセンサ24のターゲッ ト板22を取り付け、2カ所に可動部1を固定する固定 金具23を配置する構成となっている。このため、制振 機構の取り付け位置は、これらセンサのターゲット板2 2とセンサホルダ25の間、および2カ所の固定金具2 3と固定台2との間のいずれかの位置に配置するか、も 50 リーン度を実現することができる。

しくはクランプ天板5の残る面取り箇所の5カ所のうち の、いずれかに配置することが望ましい。ここでは、前 者の例として、固定金具23と制振機構を取り付ける中 継ブロック27aとを統合した構成をとっており、スペ ース効率がよい。図9は、後者のうちの1例として、3 個の制振機構を取り付けた例を示す。

【0030】 [実施例3] 図10は、本発明の第3の実 施例に係る駆動要素の断面を示す。同図の駆動要素 4 は、ベローズ9と2個のフランジ10aおよび10bと 防振ゴム31によって構成されている。一方のフランジ 10 10 aは、図2に示すように、板ばね片3の隙間からク ランプ天板5に連結され、他方のフランジ10bは、固 定台2内に配置されており、ベローズ9内部に与えられ る空気圧力を可動台1に伝達する。

【0031】本実施例のようなベローズ9内部に防振ゴ ム31を配置した駆動要素4の場合、機構の動作に減衰 特性を加えることができ、かつ防振ゴム31から発生す る塵などを圧縮空気部から出さないという点で高クリー ン度を実現することができる。

【0032】ベローズ9の自由長さは、駆動時の動作安 定のために、セット長より長くとるが、ペローズ9の内 部に配置する防振ゴム31も、ベローズ9の有効長さと 同一寸法にすることが望ましい。

【0033】防振ゴム31の両端は、図11 (a) に示 すようにフランジ10a、10bに設けた溝にはめ込む か、図11(b)に示すようにフランジ10a、10b に設けた段差にはめ込むか、あるいは図11(c)に示 すように接着剤32で接着することが、駆動以外の方向 のずれを軽減し、またベローズ9のフランジ10a、1 0 b との溶接時の熱変形を妨げる上で望ましい。また、 防振ゴム31の両端に接着剤32を塗布した上で溝には め込むなど複数の方法を併用してもよい。

【0034】防振ゴム31は、図12に示すように、側 面に1個以上の穴が開けてあることが望ましい。この場 合には、ベローズ9の有効面積を大きく使え、駆動力を 増すことができる。

【0035】 [実施例4] 図13は、本発明の第4の実 施例に係る駆動要素の断面を示す。同図の駆動要素4 は、ベローズ9と2個のフランジ10a、10b、およ びショックアプソーバ(緩衝器)51によって構成され ている。一方のフランジ10aは、図2に示すように、 板ばね片3の隙間からクランプ天板5に連結され、他方 のフランジ10bは、固定台2内に配置されており、ベ ローズ9内部に与えられる空気圧力を可動台1に伝達す る。

【0036】本実施例のようなベローズ9内部にショッ クアプソーバ51を配置した駆動要素4の場合、機構の 動作に減衰特性を加えることができ、かつ摺動部から発 生する塵などを圧縮空気部から出さないという点で高ク

【0037】両フランジ10a、10bとショックアプソーバ51との締結部には圧縮空気が漏れないように、例えば図13のようにOリング53でシールし、他端はフランジ部を貫通しないようなねじ孔で締結することにより漏れを防ぐのもよい。

【0038】ショックアプソーバ51は、図13に示すような単孔オリフィス52とオイルを用いた構造以外の構造のものを用いてもよい。

【0039】[実施例5] 図14は、本発明の第5の実施例に係る光学要素移動機構の平面図および断面図を示 10 す。本実施例は、摺動部から発生する塵などが周囲の環境に影響を及ぼさないために、図15に示すように金属のベローズ54などで覆ったショックアプソーバ51など緩衝器を、クランプ天板5に取り付けた中継プロック27bの間に配置する構成となっている。図14の例では、3個の緩衝装置を取り付けた場合を示している。この配置によって、ショックアプソーバ51を交換することも容易にできる。ショックアプソーバ51は、図13に示すような単孔オリフィス52とオイルを用いた構造以外の構造 20のものを用いてもよい。

【0040】図14に示す光学要素移動機構ではクランプ天板5に光軸周りに8カ所の面取りを設け、そのうち1カ所に可動台1の位置を計測するセンサターゲットを取り付け、2カ所に可動部1を固定する固定金具23を配置する構成となっている。このため、ショックアブソーバ51の取り付け位置は、これらセンサターゲット22とセンサホルダ25の間、および2カ所の固定金具23とセンサホルダ25の間のいずれかの位置に配置するか、もしくはクランプ天板5の残る面取り箇所の5カ所のうちの、いずれかに配置することが望ましい。ここでは、前者の例として、固定金具23とショックアブソーバ51を取り付ける中継ブロック27aとを統合した構成をとっており、スペース効率がよい。

【0041】図16は、後者のうちの1例として、3個のショックアプソーバ51を取り付けた例を示す。

【0042】 [実施例6] 図17は、本発明の第6の実施例に係る光学要素移動機構の平面図および断面図を示す。本実施例は、摺動部から発生する塵などが周囲の環境に影響を及ばさないために、図18に示すように金属40のベローズ61などで覆った防振ゴム21を、クランプ天板5に取り付けた中継ブロック27aと固定台2に取り付けた中継ブロック27bの間に配置する構成となっている。図17の例では、3個の防振ゴム21を取り付けた場合を示している。この配置によって、防振ゴム21を交換することも容易にできる。

【0043】図17に示す光学要素移動機構ではクランプ天板5に光軸周りに8カ所の面取りを設け、そのうち1カ所に可動台1の位置を計測するセンサターゲットを取り付け、2カ所に可動部1を固定する固定金具23を50

10

配置する構成となっている。このため、防振ゴム21の取り付け位置は、これらセンサターゲット22とセンサホルダ25の間、および2カ所の固定金具23と固定台2との間のいずれかの位置に配置するか(この場合、2個の中継ブロック27a、27bはそれぞれセンサターゲットとセンサホルダ、固定金具23で代用することができる)、もしくはクランプ天板5の残る面取り箇所の5カ所のうちのいずれかに配置することが望ましい。図17は、前者の例として、固定金具23とショックアブソーパ51を取り付ける中継ブロック27aとを統合した構成をとっており、スペース効率がよい。

【0044】図19は、後者のうちの1例として、3個の防振ゴム21を取り付けた例を示す。

[0045]

【デバイス生産方法の実施例】次に上記説明した露光装 置または露光方法を利用したデバイスの生産方法の実施 例を説明する。図20は微小デバイス(ICやLSI等 の半導体チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッ ド、マイクロマシン等)の製造のフローを示す。ステッ プ1 (回路設計) ではデバイスのパターン設計を行な う。ステップ2(マスク製作)では設計したパターンを 形成したマスクを製作する。一方、ステップ3 (ウエハ 製造)ではシリコンやガラス等の材料を用いてウエハを 製造する。ステップ4 (ウエハプロセス) は前工程と呼 ばれ、上記用意したマスクとウエハを用いて、リソグラ フィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次 のステップ5 (組み立て) は後工程と呼ばれ、ステップ 4によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化す る工程であり、アッセンプリ工程(ダイシング、ボンデ ィング)、パッケージング工程(チップ封入)等の工程 を含む。ステップ6 (検査) ではステップ5で作製され た半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の 検査を行なう。こうした工程を経て半導体デバイスが完 成し、これが出荷(ステップ7)される。

【0046】図21は上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す。ステップ11(酸化)ではウエハの表面を酸化させる。ステップ12(CVD)ではウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ13(電極形成)ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ14(イオン打込み)ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ15(レジスト処理)ではウエハに感光剤を塗布する。ステップ16(露光)では上述の光学要素移動装置をよってマスクの回路パターンをウエハに焼付露光する。ステップ17(現像)では露光したウエハを現像する。ステップ18(エッチング)では現像レジスト像以外の部分を削り取る。ステップ19(レジスト像以外の部分を削り取る。ステップ19(レジスト剝離)ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。これらのステップを繰り返し行なうことによって、ウエハ上に多重に回路パターンが形成され

【0047】本実施例の生産方法を用いれば、従来は製 造が難しかった高集積度のデバイスを低コストに製造す ることができる。

[0048]

【発明の効果】本発明によれば、投影光学系の倍率、収 差、歪み等の光学特性を調整するための光学要素を高精 度で光軸上を駆動する光学要素移動装置を、省スペー ス、高クリーン度で実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明が適用される露光装置の構成を示す図 10 である。

【図2】 本発明が適用される平行板ばね機構を用いた 光学要素移動装置の平面図および断面図である。

駆動要素のベローズ内に粘性体を配置した本 発明の第1の実施例に係るダンパ手段の構成を示す図で ある。

【図4】 第1の実施例の変形例を示す図である。

【図5】 第1の実施例のさらなる変形例を示す図であ る。

【図6】 第1の実施例におけるピストンの変形例を示 20 る。 す図である。

【図7】 粘性体を有するダンパ手段を機構外部に配置 した本発明の第2の実施例に係る光学要素移動装置の平 面図および断面図である。

【図8】 図7におけるダンパ手段の詳細構成を示す図 である。

【図9】 第2の実施例の変形例を示す光学要素移動装 置の平面図および断面図である。

駆動要素のベローズ内に防振ゴムを配置し た本発明の第3の実施例に係るダンパ手段の構成を示す 30 た、22:ターゲット板、23:パランス板、25:セ 図である。

【図11】 第3の実施例の変形例を示す図である。

【図12】 第3の実施例における防振ゴムの詳細を示 す図である。

【図13】 駆動要素のベローズ内にショックアブソー バを配置した本発明の第4の実施例に係るダンパ手段の 構成を示す図である。

12

ショックアプソーバを有するダンパ手段を 【図14】 機構外部に配置した本発明の第5の実施例に係る光学要 素移動装置の平面図および断面図である。

【図15】 第5の実施例におけるダンパ手段の詳細を 示す図である。

【図16】 第5の実施例の変形例を示す光学要素移動 装置の平面図および断面図である。

防振ゴムを有するダンパ手段を機構外部に 【図17】 配置した本発明の第6の実施例に係る光学要素移動装置 の平面図および断面図である。

【図18】 図17におけるダンパ手段の詳細構成を示 す図である。

【図19】 第6の実施例の変形例を示す光学要素移動 装置の平面図および断面図である。

【図20】 微小デバイスの製造の流れを示す図であ

【図21】 図20におけるウエハプロセスの詳細な流 れを示す図である。

【図22】 従来の駆動要素の構成を示す図である。 【符号の説明】

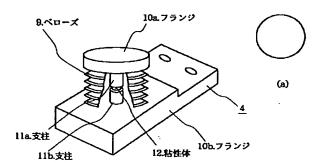
1:可動台、2:固定台、3:板ばね、4:駆動要素、 5:クランプ天板、6:板ばね押さえ、7:レンズ、

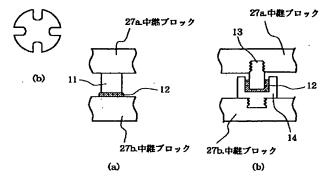
8:セル、9:ベローズ、10a, 10b:フランジ、 11:支柱、12:粘性体、13:ピストン、14:シ

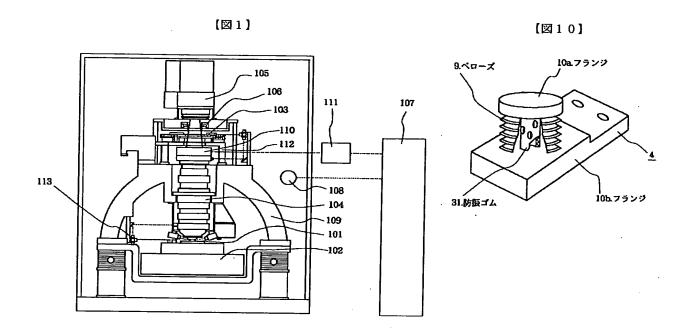
リンダ、15、53:0リング、16:継手、17:ふ ンサホルダ、26:固定金具、27a, 27b:中継ブ ロック、31:防振ゴム、32:接着剤、51:ショッ

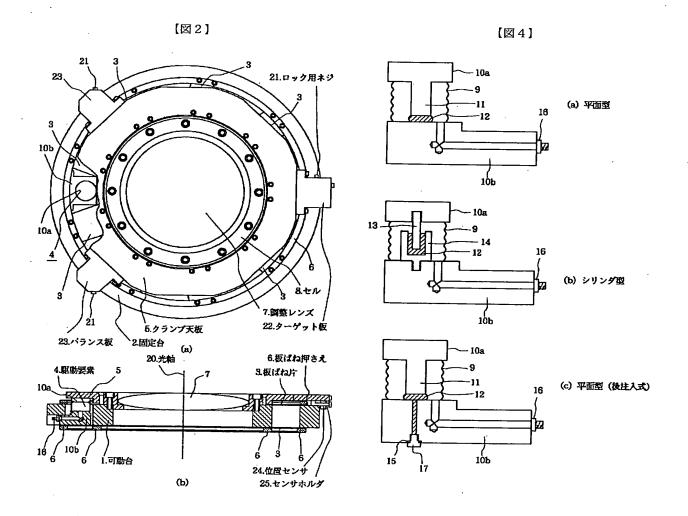
クアプソーバ、54,61:ベローズ。

【図3】 【図6】 [図8]

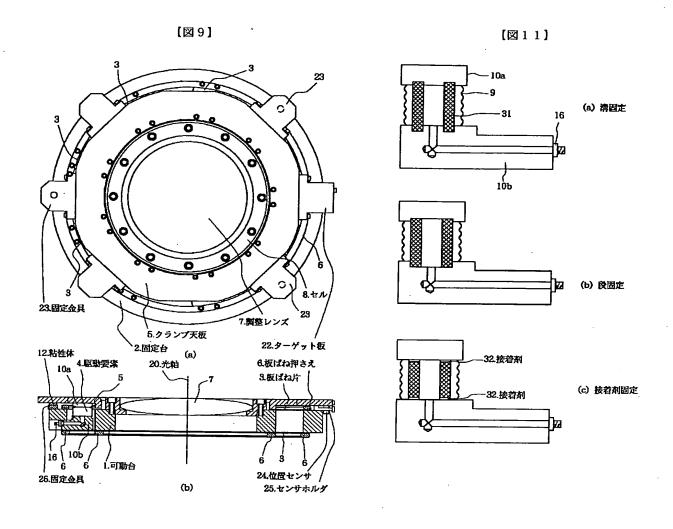


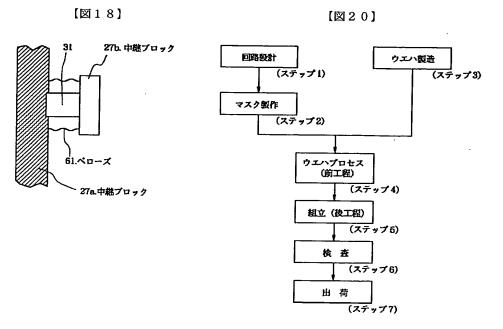






[図5] [図7] -10a 23 (a) シリンダ型 後注入方式その1 16 10ъ 10ъ - 10a (b) シリンダ型 後注入方式その2 } / 15 17 10ъ 22.ターゲット仮 23. 固定金具 2.固定台 12.粘性体 (a) 20.光轴 6.板ばね押さえ 4.駆動要素 3.板ばね片 (c) シリンダ型 後生入方式その3 16 10ъ (ъ) 25.センサホルダ 【図12】 【図13】 【図15】 27a.中継ブロック .63.0 リング 51.ショックアプソーバ 防振ゴムの穴 ベローズ内部にアプソーバを配置・ 52ペローズ [図22] 動作方向





半導体デバイス製造フロー

25.センサホルダ

(p)

【図14】 【図16】 51 21.ロック用ネジ 23 10ъ 23.固定金具 22.ターゲット板 5.クランプ天板 2.固定台 5.クランプ天板 51.ショックアプソ・ 22.ターゲット板 23.固定金具 51.ショックアブソーバ 2.固定台 ______(a) 20.光軸 (a) 12.粘性体 51.ショックアプソーバ 10a 4 区勒要素 6.板ばわ押さえ 20.光轴 6.板ばね押さえ 4.取動要案 3.板ばね片 3.板ばね片 1.可助台

26.固定金具

24.位置センザ

25.センサホルダ

酸 化 レジスト処理 (ステップ11) (ステップ 15) CVD 餌 光 (ステップ12) (ステップ 16) 電極形成 (ステップ13) (ステップ 17) イオン打込み エッチング (ステップ14) (ステップ 18) レジスト剝離 (ステップ 19)

(p)

【図21】

ウエハプロセス

繰り返し

